

QJ

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ/Z 146~160-85

QJ 930~934-85

电子装联标准汇编

1985—10—01 发布

1985—10—01 实施

中华人民共和国航天工业部 批准

目 录

QJ /Z 146-85	导线端头处理工艺细则	(1)
QJ /Z 147-85	电子元器件搪锡工艺细则	(13)
QJ /Z 148-85	漆包线去漆膜工艺细则	(19)
QJ /Z 149-85	镀膜导线酸洗工艺细则	(21)
QJ /Z 150-85	导线热压打标记工艺细则	(25)
QJ /Z 151-85	螺纹连接胶封和点标志漆工艺细则	(29)
QJ /Z 152-85	圆导体带状电缆安装工艺细则	(33)
QJ /Z 153-85	MOS集成电路安装工艺细则	(37)
QJ /Z 154-85	印制电路板组装件装联工艺细则	(41)
QJ /Z 155-85	绕接工艺细则	(51)
QJ /Z 156-85	SO ₁₋₃ 聚氨酯清漆防护喷涂工艺细则	(59)
QJ /Z 157-85	氮化硼浇注工艺细则	(63)
QJ /Z 158-85	汽相清洗工艺细则	(73)
QJ /Z 159.1-85	整机及部件密封灌注工艺细则	(75)
QJ /Z 159.2-85	印制电路板组装件灌封工艺细则	(83)
QJ /Z 159.3-85	局部封装工艺细则	(87)
QJ /Z 159.4-85	磁蕊板灌封工艺细则	(91)
QJ /Z 160-85	手工锡焊工艺细则	(95)
QJ 930-85	绕接技术条件	(105)
QJ 931-85	电子产品控制多余物规范	(115)

1 适用范围

1.1 本标准采用氮化硼作为绝热材料,使电子产品在特殊高温条件下短时期工作时能防止电子元器件失效、特性漂移过量及导线焊点熔化脱落。经氮化硼浇注层包覆的电路具有良好的绝热、防潮和防腐蚀性能。

1.2 作为瞬间火焰直射下的防火包覆层。

2 引用文件

自本标准批准之日起,下列文件在本文规定范围内构成本标准的一个组成部份。

GB1040—79塑料拉伸试验方法。

GB1043—79塑料筒支梁冲击试验方法。

GB1409—78固体电工绝缘材料在工频、音频、高频下相对介电系数和介质损耗角正切试验方法。

GB1394—77电工绝缘热固性层压制品通用试验方法。

GB1408—78固体电工绝缘材料工频击穿电压、击穿强度和耐压试验方法。

QJ/Z158—85《汽相清洗工艺细则》

3 材料、工具及设备

3.1 材料

表 1

序号	名 称	牌 号	技术标准
1	618环氧树脂	E-51	HG 2—741—72
2	氮化硼*	—	含量98%,粒度300目
3	邻苯二甲酸二丁脂	化学纯	HGB 3135—59
4	2-乙基 4-甲基咪唑**	化学纯	(见附录A)
5	丙酮	化学纯	GB686—78
6	无水乙醇	化学纯	GB678—78

3.2 工具及设备

表 2

序号	名 称	规 格
1	普通药物天平	称量:1000g,感量:0.1g
2	真空烘箱	工作温度:160°C,真空度:1.33Pa(1×10^{-2} Torr)
3	干燥箱	工作温度:250°C